

# Dell EMC PowerEdge R750xs

## 仕様詳細

## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>章 1: 仕様詳細</b> ..... | <b>4</b> |
| シャーシ寸法.....            | 5        |
| システムの重量.....           | 6        |
| プロセッサの仕様.....          | 6        |
| PSU の仕様.....           | 6        |
| 対応オペレーティング システム.....   | 7        |
| 冷却ファンの仕様.....          | 7        |
| システムバッテリーの仕様.....      | 9        |
| 拡張カードライザーの仕様.....      | 9        |
| メモリーの仕様.....           | 10       |
| ストレージ コントローラーの仕様.....  | 10       |
| ドライブ.....              | 11       |
| ポートおよびコネクタの仕様.....     | 11       |
| USB ポートの仕様.....        | 11       |
| シリアル コネクタの仕様.....      | 11       |
| NIC ポートの仕様.....        | 12       |
| VGA ポートの仕様.....        | 12       |
| ビデオの仕様.....            | 12       |
| 環境仕様.....              | 12       |
| 粒子状およびガス状汚染物質の仕様.....  | 13       |
| 温度に関する制限のマトリックス.....   | 14       |

# 仕様詳細

本項では、お使いのシステムの仕様詳細と環境仕様の概要を示します。

## トピック：

- シャーシ寸法
- システムの重量
- プロセッサの仕様
- PSU の仕様
- 対応オペレーティング システム
- 冷却ファンの仕様
- システムバッテリーの仕様
- 拡張カードライザーの仕様
- メモリーの仕様
- ストレージコントローラーの仕様
- ドライブ
- ポートおよびコネクタの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

# シャーシ寸法

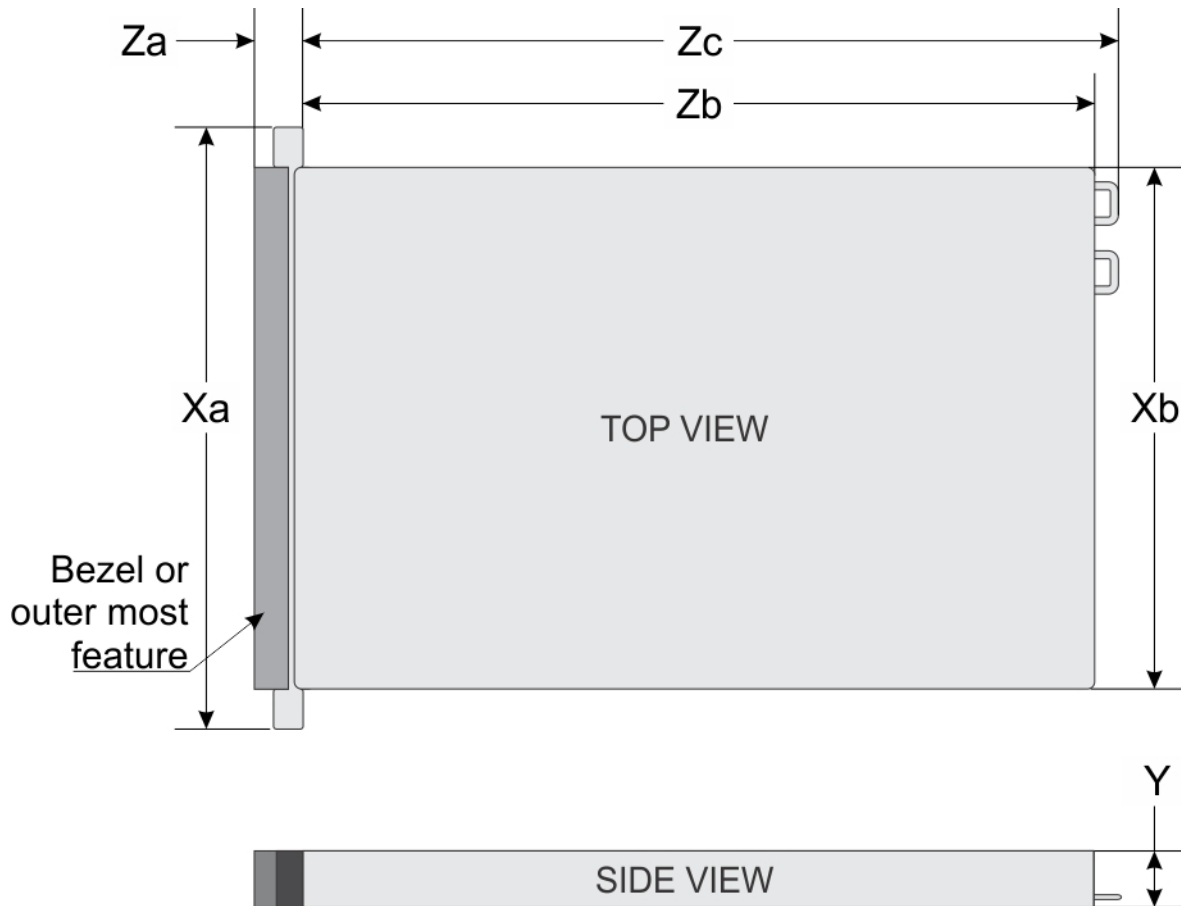


図 1. シャーシ寸法

表 1. シャーシ寸法

| ドライブ         | Xa                      | Xb                      | Y                     | Za  | Zb  | Zc  |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|---|
| 24 台のドライブ    | 482.0 mm<br>(18.97 インチ) | 434.0 mm<br>(17.08 インチ) | 86.8 mm<br>(3.41 インチ) | 22.0 mm (0.86 インチ) ベゼルなし<br>35.84 mm (1.41 インチ) ベゼルあり | 675.04 mm (26.57 インチ) イヤーから L ブラケットハウジングまで<br>650.24 mm (25.6 インチ) イヤーから PSU 表面まで | 685.78 mm (26.99 インチ) イヤーから PSU ハンドルまで<br>(面ファスナー ストラップを除く) |
| 12 台のドライブ    |                         |                         |                       |   |   |   |
| 16 台のドライブ    |                         |                         |                       |   |   |   |
| 8 台のドライブ     |                         |                         |                       |   |   |   |
| バックプレーンなしの構成 |                         |                         |                       |   |   |   |

① | **メモ:** Zb は、システム ボード I/O コネクターが設置されている公称背面外部表面を示します。

# システムの重量

表 2. PowerEdge R750xs システムの重量

| システム設定                                | 最大重量 (すべてのドライブ/SSD/ベゼルを含む) |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 24 x 2.5 インチ ( 16 SAS/SATA + 8 NVMe ) | 23.84 kg ( 52.55 lb )      |
| 16 x 2.5 インチ                          | 21.94 kg ( 48.36 lb )      |
| 12 x 3.5 インチ                          | 28.76 kg ( 63.40 lb )      |
| 8 x 3.5 インチ                           | 24.80 kg ( 54.67 lb )      |
| 8 x 2.5 インチ                           | 20.44 kg ( 45.06 lb )      |
| バックプレーンなしの構成                          | 18.54 kg ( 40.87 lb )      |

# プロセッサの仕様

表 3. PowerEdge R750xs プロセッサの仕様

| サポートされるプロセッサ                               | サポートされているプロセッサ数 |
|--|-----------------|
| 第 3 世代 インテル Xeon スケーラブル プロセッサ ( 最大 32 コア ) | 2 台まで           |

# PSU の仕様

PowerEdge R750xs システムでは、最大 2 台の AC または DC 電源供給ユニット ( PSU ) がサポートされます。

表 4. PSU の仕様

| PSU              | クラス   | 放熱 ( 最大 )<br>BTU/hr | 周波数 Hz | 電圧                            | AC                    |                    | DC     | 現在            |
|------------------|-------|---------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|---------------|
|                  |       |                     |        |                               | 高圧線<br>200 ~ 240<br>V | 低圧線 100<br>~ 120 V |        |               |
| 1400 W 混合<br>モード | プラチナ  | 5406                | 50/60  | 100 ~ 240 V<br>AC、オートレ<br>レンジ | 1400 W                | 1050 W             | NA     | 12 A ~ 8 A    |
|                  | NA    | 5406                | NA     | DC 240 V、オ<br>ートレンジ           | NA                    | NA                 | 1400 W | 6.6 A         |
| 1100 W 混合<br>モード | チタニウム | 4299                | 50/60  | 100 ~ 240 V<br>AC、オートレ<br>レンジ | 1100 W                | 1050 W             | NA     | 12 A ~ 6.3 A  |
|                  | NA    | 4299                | NA     | DC 240 V、オ<br>ートレンジ           | NA                    | NA                 | 1100 W | 5.2 A         |
| 1100 W DC        | NA    | 4265                | NA     | -48- ( -60 ) V                | NA                    | NA                 | 1100 W | 26.1 A        |
| 800 W 混合<br>モード  | プラチナ  | 3000                | 50/60  | 100 ~ 240 V<br>AC、オートレ<br>レンジ | 800 W                 | 800 W              | NA     | 9.2 A ~ 4.7 A |
|                  | NA    | 3000                | NA     | DC 240 V、オ<br>ートレンジ           | NA                    | NA                 | 800 W  | 3.8 A         |
| 600 W 混合<br>モード  | プラチナ  | 2250                | 50/60  | 100 ~ 240 V<br>AC、オートレ<br>レンジ | 600 W                 | 600 W              | NA     | 7.1 A ~ 3.6 A |

表 4. PSU の仕様 ( 続き )

| PSU | クラス | 放熱 ( 最大 )<br>BTU/hr | 周波数 Hz | 電圧                  | AC                    |                    | DC    | 現在    |
|-----|-----|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------|
|     |     |                     |        |                     | 高圧線<br>200 ~ 240<br>V | 低圧線 100<br>~ 120 V |       |       |
|     | NA  | 2250                | NA     | DC 240 V、オ<br>ートレンジ | NA                    | NA                 | 600 W | 2.9 A |

① **メモ:** このシステムは、相間電圧が 240 V 以下の IT 電力システムに接続できるようにも設計されています。

① **メモ:** 熱消費は PSU のワット定格を使用して算出されています。

① **メモ:** システム構成を選択またはアップグレードする場合は、最適な電力使用率を達成できるように、[ Dell.com/ESSA ] で入手できる Dell Energy Smart Solution Advisor でシステムの電力消費量を検証します。

## 対応オペレーティング システム

PowerEdge R750xs システムは、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

詳細については、 [www.dell.com/ossupport](http://www.dell.com/ossupport) を参照してください。

## 冷却ファンの仕様

### 冷却ファンの仕様

PowerEdge R750xs システムでは、最大 6 台の標準ファン、ハイ パフォーマンス シルバー グレード ファン、またはハイ パフォーマンス ゴールド グレード ファン がサポートされます。

表 5. 冷却ファンの仕様


| ファンのタイプ   | 略語  | 別名  | ラベルの色 | ラベルの画像  |
|-----------|-----|-----|-------|---|
| [ 標準ファン ] | STD | STD | ラベルなし |  |

表 5. 冷却ファンの仕様 ( 続き )

| ファンのタイプ                       | 略語       | 別名                 | ラベルの色 | ラベルの画像   |
|-------------------------------|----------|--------------------|-------|--|
| [ハイパフォーマンス ( シルバー グレード ) ファン] | HPR SLVR | HPR                | シルバー  | <p>① <b>メモ:</b> 新しい冷却ファンには、ハイパフォーマンス シルバー グレードのラベルが付いています。古い冷却ファンには、ハイパフォーマンスのラベルが付いています。</p>  <p>図 2. ハイ パフォーマンス ファン</p>  <p>図 3. ハイ パフォーマンス ( シルバー グレード ) ファン</p> |
| [ハイパフォーマンス ( ゴールド グレード ) ファン] | HPR GOLD | VHPR : 超ハイ パフォーマンス | ゴールド  | <p>① <b>メモ:</b> 新しい冷却ファンには、ハイパフォーマンス ゴールド グレードのラベルが付いています。古い冷却ファンには、ハイパフォーマンスのラベルが付いています。</p>  |

表 5. 冷却ファンの仕様 ( 続き )

| ファンのタイプ | 略語 | 別名 | ラベルの色 | ラベルの画像  |
|---------|----|----|-------|---|
|         |    |    |       |  <p>図 4. 超ハイ パフォーマンス ファン</p>               |
|         |    |    |       |  <p>図 5. ハイ パフォーマンス ( ゴールド グレード ) ファン</p> |

① **メモ:** STD ファン、HPR SLVR ファン、HPR GOLD ファンの混在はサポートされていません。

① **メモ:** STD ファン、HPR SLVR ファン、HPR GOLD ファンの取り付けは、システム構成によって異なります。サポートされるファンの構成またはマトリックスの詳細については、「[温度制限マトリックス](#)」を参照してください。

## システムバッテリーの仕様

PowerEdge R750xs システムは、CR 2032 3.0 V コイン型リチウム電池システム バッテリーをサポートします。

## 拡張カードライザーの仕様

PowerEdge R750xs システムでは、最大 6 個の PCI express ( PCIe ) Gen 4 拡張カードがサポートされます。

表 6. システム ボードで使用できる拡張カード スロット

| PCIe スロット | 拡張カードライザー | プロセッサの接続 | 高さ       | 長さ      | スロット幅 |
|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------|
| スロット 1    | 該当なし      | プロセッサ-1  | ロープロファイル | ハーフレングス | x16   |

表 6. システム ボードで使用できる拡張カード スロット ( 続き )

| PCIe スロ<br>ット | 拡張カードライザー         | プロセッサの接続          | 高さ       | 長さ       | スロット幅          |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------------|
| スロット 2        | 該当なし              | PCH               | ロープロファイル | ハーフ レングス | x8 ( x4-リンク )  |
| スロット 3        | ライザー 1A           | プロセッサ 1           | ロープロファイル | ハーフ レングス | x16            |
| スロット 4        |                   | プロセッサ 2           | ロープロファイル | ハーフ レングス | x16            |
| スロット 3        | ライザー 1B ( SNAPI ) | プロセッサ 1 およ<br>び 2 | ロープロファイル | ハーフ レングス | x16            |
| スロット 4        |                   | プロセッサ 2           | ロープロファイル | ハーフ レングス | x16 ( x8-リンク ) |
| スロット 5        | 該当なし              | プロセッサ 2           | ロープロファイル | ハーフ レングス | x16            |
| スロット 6        | 該当なし              | プロセッサ 2           | ロープロファイル | ハーフ レングス | x16            |

①メモ: すべての構成において、一度に設置できるケーブル ライザーは 1 個だけです。

## メモリーの仕様

PowerEdge R750xs システムでは、作動を最適化するために次のメモリー仕様がサポートされます。

表 7. メモリーの仕様

| DIMM のタイ<br>プ | DIMM のランク | DIMM の容<br>量 | シングル プロセッサ |            | デュアル プロセッサ     |            |
|---------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|------------|
|               |           |              | 最小 DIMM 容量 | 最大 DIMM 容量 | 最小 DIMM 容<br>量 | 最大 DIMM 容量 |
| RDIMM         | シングルランク   | 8 GB         | 8 GB       | 64 GB      | 16 GB          | 128 GB     |
|               | デュアルランク   | 16 GB        | 16 GB      | 128 GB     | 32 GB          | 256 GB     |
|               |           | 32 GB        | 32 GB      | 256 GB     | 64 GB          | 512 GB     |
|               |           | 64 GB        | 64 GB      | 512 GB     | 128 GB         | 1 TB       |

表 8. メモリー モジュール ソケット

| メモリー モジュール ソケット | 速度                            |
|-----------------|-------------------------------|
| 288 ピン ( 16 )   | 3200 MT/s、2933 MT/s、2666 MT/秒 |

## ストレージ コントローラーの仕様

PowerEdge R750xs システムでは、次のコントローラー カードがサポートされます。

表 9. システム用のストレージ コントローラー カード

| 内部コントローラー  | 外部コントローラー  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H755</li> <li>PERC H755N</li> <li>PERC H745</li> <li>PERC H355</li> <li>PERC H345</li> <li>HBA355i</li> <li>S150</li> <li>Boot Optimized Storage Subsystem ( BOSS-S2 ) : HWRAID 2 x M.2 SSD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>HBA355e</li> <li>PERC H840</li> </ul> |

- ① **メモ:** ソフトウェア RAID コントローラー S150 は、チップセット SATA のみのバックプレーンを備えた SATA ドライブ、またはプロセッサ 直接 PCIe ケーブルが接続されたバックプレーンを備えたユニバーサル スロットの NVMe ドライブでサポートされます。

## ドライブ

PowerEdge R750xs システムでは、次のものがサポートされます。

- 24 x 2.5 インチ ( 16 SAS/SATA + 8 NVMe ) ドライブ
- 16 x 2.5 インチ SAS または SATA ドライブ
- 12 x 3.5 インチ SAS または SATA ドライブ
- 8 x 2.5 インチ SAS または SATA ドライブ
- 8 x 2.5 インチ NVMe ドライブ
- 8 x 3.5 インチ SAS または SATA ドライブ

- ① **メモ:** NVMe PCIe SSD U.2 デバイスをホットスワップする方法の詳細については、<https://www.dell.com/support> [ 全製品の閲覧 ] > [ データセンターインフラストラクチャ ] > [ ストレージアダプターとコントローラー ] > [ Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD ] > [ ドキュメント ] > [ マニュアルとドキュメント ] から、*Dell Express Flash NVMe PCIe SSD ユーザーガイド*を参照してください。

## ポートおよびコネクタの仕様

### USB ポートの仕様

表 10. PowerEdge R750xs の USB 仕様

| 正面                         |       | 背面            |       | 内蔵 ( オプション )     |       |
|----------------------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|
| USB ポート タイプ                | 数ポート数 | USB ポート タイプ   | 数ポート数 | USB ポート タイプ      | 数ポート数 |
| USB 2.0 対応ポート              | 1 回   | USB 2.0 対応ポート | 1 回   | 内蔵 USB 3.0 対応ポート | 1 回   |
| Micro-USB 2.0 iDRAC Direct | 1 回   | USB 3.0 対応ポート | 1 回   |                  |       |

- ① **メモ:** Micro USB 2.0 対応ポートは、iDRAC 直接または管理ポートとしてのみ使用できます。
- ① **メモ:** USB 2.0 の仕様では、単一のワイヤに 5 V の電力を供給して、接続されている USB デバイスに電源を供給します。ユニットのロードは、USB 2.0 では 100 mA、USB 3.0 では 150 mA に定義されています。デバイスでは、USB 2.0 のポートから最大 5 ユニット ロード ( 500 mA ) を引き出し、USB 3.0 のポートから最大 6 ユニット ロード ( 900 mA ) を引き出す可能性があります。
- ① **メモ:** USB 2.0 のインターフェイスにより、低電力の周辺機器類に電力を供給できますが、USB の仕様に準拠している必要があります。外部の CD/DVD ドライブといった高電力の周辺機器類を機能させるには、外部の電源が必要です。

### シリアルコネクタの仕様

PowerEdge R750xs システムは、システム背面においてオプションのカードタイプシリアルコネクタ x 1 のサポートをしています。このコネクタは、9 ピンコネクタ、データ端末装置 ( DTE )、16550 準拠です。

オプションのシリアルコネクタカードの取り付け手順は、拡張カードフィラーブラケットと同じです。

## NIC ポートの仕様

PowerEdge R750xs システムでは、LAN on Motherboard ( LOM ) に組み込まれ、オプションの Open Compute Project ( OCP ) カードに内蔵された 10/100/1000 Mbps ネットワーク インターフェイス コントローラー ( NIC ) ポートが最大 2 個サポートされます。

表 11. システムの NIC ポートの仕様

| 特長                  | 仕様  |
|---------------------|---|
| LOM                 | 2 x 1 GB  |
| OCP カード ( OCP 3.0 ) | 4 x 1 GbE、2 x 10 GbE、2 x 25 GbE、4 x 25 GbE、2 x 50 GbE、2 x 100 GbE |

## VGA ポートの仕様

PowerEdge R750xs システムは、2 個の DB-15 VGA ポート ( システムの前面パネルおよび背面パネルに各 1 個 ) を備えています。

## ビデオの仕様

Dell EMC PowerEdge R750xs システムでは、16 MB のビデオ フレーム バッファを備えた内蔵グラフィック コントローラー Matrox G200 がサポートされます。

表 12. システムでサポートしているビデオ解像度のオプション

| 解像度         | リフレッシュレート ( Hz ) | 色深度 ( ビット ) |
|-------------|------------------|-------------|
| 1024 x 768  | 60               | 8、16、32     |
| 1280 x 800  | 60               | 8、16、32     |
| 1280 x 1024 | 60               | 8、16、32     |
| 1360 x 768  | 60               | 8、16、32     |
| 1440 x 900  | 60               | 8、16、32     |
| 1600 x 900  | 60               | 8、16、32     |
| 1600 x 1200 | 60               | 8、16、32     |
| 1680 x 1050 | 60               | 8、16、32     |
| 1920 x 1080 | 60               | 8、16、32     |
| 1920 x 1200 | 60               | 8、16、32     |

## 環境仕様

📌 **メモ:** 環境証明の詳細については、[www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home) の [ ドキュメント ] > [ 規制情報 ] にある **製品環境データシート** を参照してください。

表 13. 動作環境範囲カテゴリ A2

| 温度                                | 仕様   |
|-----------------------------------|--|
| 許容可能な継続動作                         |  |
| 高度 <= 900 m ( <= 2,953 ft ) の温度範囲 | 10 ~ 35°C ( 50 ~ 95°F )、装置への直射日光なし   |
| 湿度範囲 ( 常に結露なし )                   | 8% RH で最低露点 -12°C ~ 80% RH で最大露点 21°C ( 69.8°F )                             |
| 動作高度減定格                           | 900 m ( 2,953 Ft ) を越える高度では、最高温度は 300 m ごとに 1°C ( 984 Ft ごとに 1.8°F ) 低くなります。 |

表 14. 動作環境範囲カテゴリー A3

| 温度                                | 仕様   |
|-----------------------------------|--|
| 許容可能な継続動作                         |  |
| 高度 <= 900 m ( <= 2,953 ft ) の温度範囲 | 5 ~ 40°C ( 41 ~ 104°F )、装置への直射日光なし   |
| 湿度範囲 ( 常に結露なし )                   | 8% RH で最低露点 -12°C ~ 85% RH で最大露点 24°C ( 75.2°F )                             |
| 動作高度減定格                           | 900 m ( 2,953 Ft ) を越える高度では、最高温度は 175 m ごとに 1°C ( 574 Ft ごとに 1.8°F ) 低くなります。 |

表 15. 動作環境範囲カテゴリー A4

| 温度                                | 仕様   |
|-----------------------------------|--|
| 許容可能な継続動作                         |  |
| 高度 <= 900 m ( <= 2,953 ft ) の温度範囲 | 5°C ~ 45°C ( 41°F ~ 113°F )、装置への直射日光なし                                       |
| 湿度範囲 ( 常に結露なし )                   | 8% RH で最低露点 -12°C ~ 90% RH で最大露点 24°C ( 75.2°F )                             |
| 動作高度減定格                           | 900 m ( 2,953 Ft ) を越える高度では、最高温度は 125 m ごとに 1°C ( 410 Ft ごとに 1.8°F ) 低くなります。 |

表 16. すべてのカテゴリーに共通する要件

| 温度                        | 仕様  |
|---------------------------|---|
| 許容可能な継続動作                 |   |
| 最大温度勾配 ( 動作時と非動作時の両方に適用 ) | 1 時間で 20°C* ( 1 時間で 36°F )、15 分間で 5°C ( 15 分間で 9°F )、テープの場合は 1 時間で 5°C* ( 1 時間で 9°F )<br><b>①</b>   <b>メモ:</b> * : テープハードウェアの ASHRAE 温度ガイドラインにより、これらは温度変化の瞬間レートではありません。 |
| 非動作時の温度制限                 | -40 ~ 65°C ( -104 ~ 149°F )   |
| 非動作時の湿度制限 ( 常に結露なし )      | 5% ~ 95% RH で最大露点 27°C ( 80.6°F )   |
| 非動作時の最大高度                 | 12,000 メートル ( 39,370 フィート )   |
| 動作時の最大高度                  | 3,048 メートル ( 10,000 フィート )  |

表 17. 最大振動の仕様

| 最大耐久震度 | 仕様   |
|--------|--|
| 動作時    | 0.21Grms ( 5Hz ~ 500Hz ) で 10 分間 ( x、y、z 軸すべて )  |
| ストレージ  | 1.88Grms ( 10Hz ~ 500Hz ) で 15 分間 ( 全 6 面で検証済み ) |

表 18. 最大衝撃パルス仕様

| 最大衝撃パルス | 仕様   |
|---------|--|
| 動作時     | x、y、z 軸の正方向および負方向に 6 連続衝撃パルス、11 ミリ秒以下で 6G。                     |
| ストレージ   | x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス ( システムの各面に対して 1 パルス )、2 ミリ秒以下で 71G。 |

## 粒子状およびガス状汚染物質の仕様

次の表は、粒子汚染およびガス状汚染物による IT 装置の損傷または故障またはその両方を避けるために役立つ制限事項を定義しています。粒子汚染またはガス汚染のレベルが指定された制限を超え、機器の損傷または故障の原因となる場合、環境条件の変更が必要になります。環境状態の修復は、お客様の責任となります。

表 19. 粒子状汚染物質の仕様

| 粒子汚染   | 仕様   |
|--------|--|
| 空気清浄   | <p>データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。</p> <p>① <b>メモ:</b> この条件はデータセンターの環境にのみ適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。</p> <p>① <b>メモ:</b> データセンターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。</p> |
| 伝導性ダスト | <p>空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウィスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。</p> <p>① <b>メモ:</b> この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>   |
| 腐食性ダスト | <ul style="list-style-type: none"> <li>空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。</li> <li>空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。</li> </ul> <p>① <b>メモ:</b> この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>  |

表 20. ガス状汚染物質の仕様

| ガス状汚染物   | 仕様  |
|----------|---|
| 銅クーポン腐食度 | クラス G1 ( ANSI/ISA71.04-2013 の定義による ) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満。 |
| 銀クーポン腐食度 | ANSI/ISA71.04-2013 の定義に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満                 |

① **メモ:** 50% 以下の相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル

## 温度に関する制限のマトリックス

表 21. 温度に関する制限のマトリックス

| 構成               |       | 8 x 2.5 インチ NVMe          | 16 x 2.5 インチ SAS/SATA + 8 x 2.5 インチ NVMe | 12 x 3.5 インチ SAS/SATA          | 周囲温度 |
|------------------|-------|---------------------------|--|--------------------------------|------|
| 背面ストレージ          |       | 背面ドライブなし                  | 背面ドライブなし                                 | 背面ドライブなし                       |      |
| [ CPU TDP/cTDP ] | 105 W | HPR ファン x 5<br>2U STD HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U STD HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |
|                  | 120 W | HPR ファン x 5<br>2U STD HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U STD HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |
|                  | 135 W | HPR ファン x 5<br>2U STD HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U STD HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |
|                  | 150 W | HPR ファン x 5<br>2U STD HSK | HPR シルバー ファン x 5                         | HPR シルバー ファン x 5               | 35°C |

表 21. 温度に関する制限のマトリックス ( 続き )

| 構成      |       | 8 x 2.5 インチ NVMe          | 16 x 2.5 インチ SAS/SATA + 8 x 2.5 インチ NVMe | 12 x 3.5 インチ SAS/SATA          | 周囲温度 |
|---------|-------|---------------------------|--|--------------------------------|------|
| 背面ストレージ |       | 背面ドライブなし                  | 背面ドライブなし                                 | 背面ドライブなし                       |      |
|         |       |                           | 2U STD HSK                               | 2U HPR HSK                     |      |
|         | 165 W | HPR ファン x 5<br>2U HPR HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |
|         | 185 W | HPR ファン x 5<br>2U HPR HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |
|         | 205 W | HPR ファン x 5<br>2U HPR HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |
|         | 220 W | HPR ファン x 5<br>2U HPR HSK | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK           | HPR シルバー ファン x 5<br>2U HPR HSK | 35°C |

- ① **メモ:** ファン ダミーは、5 台の標準ファンと 5 台のハイ パフォーマンス ファンの構成で、ファン 1 スロットに取り付ける必要があります。背面ドライブが取り付けられている場合は、1 台のハイパフォーマンス ファン ( ゴールド グレード ) をファン 1 スロットに取り付ける必要があります。
- ① **メモ:** GPU は、どの構成でもサポートされていません。
- ① **メモ:** ライザー モジュールが取り付けられていない場合は、OCP エアフローカバーが必要です。
- ① **メモ:** プロセッサ 1 台の構成には、プロセッサ ダミーが必要です。エアフローカバーに関係なく、CPU2 の場所に DIMM ダミーが必要です。

表 22. プロセッサとヒートシンク マトリックス

| ヒートシンク     | プロセッサ TDP |
|------------|-----------|
| 2U STD HSK | < 165 W   |
| 2U HPR HSK | >= 165 W  |

表 23. ラベル参照

| ラベル          | 説明                       |
|--------------|--------------------------|
| STD          | 標準                       |
| HPR ( シルバー ) | ハイ パフォーマンス ( シルバー グレード ) |
| HPR ( ゴールド ) | ハイ パフォーマンス ( ゴールド グレード ) |
| HSK          | ヒートシンク                   |
| LP           | ロープロファイル                 |
| FH           | フルハイト                    |